

Согласовано

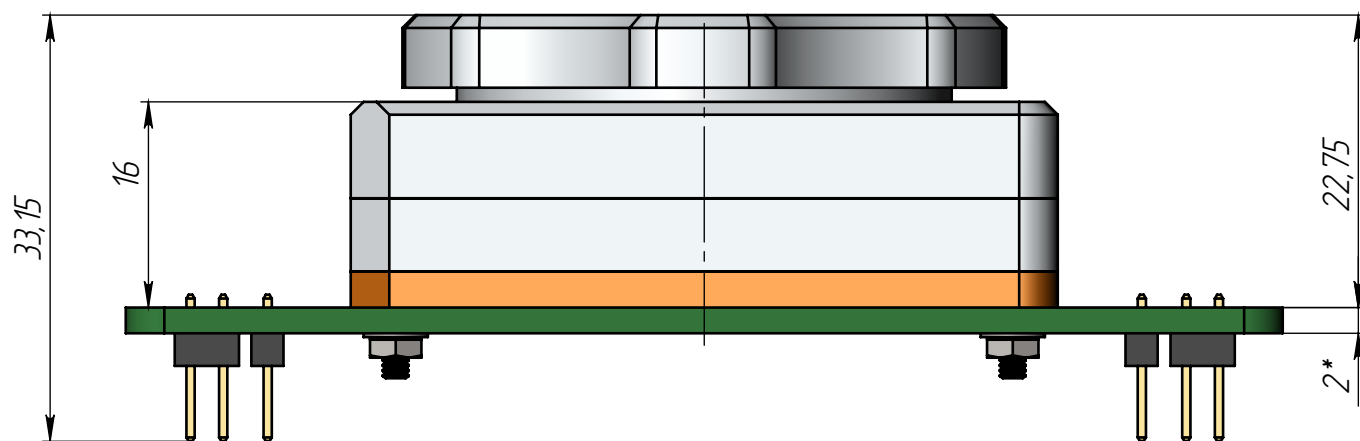
*Утверждаю
Директор
ООО "Тест-Контакт"
Сурков М.А.*

____/____2018г.

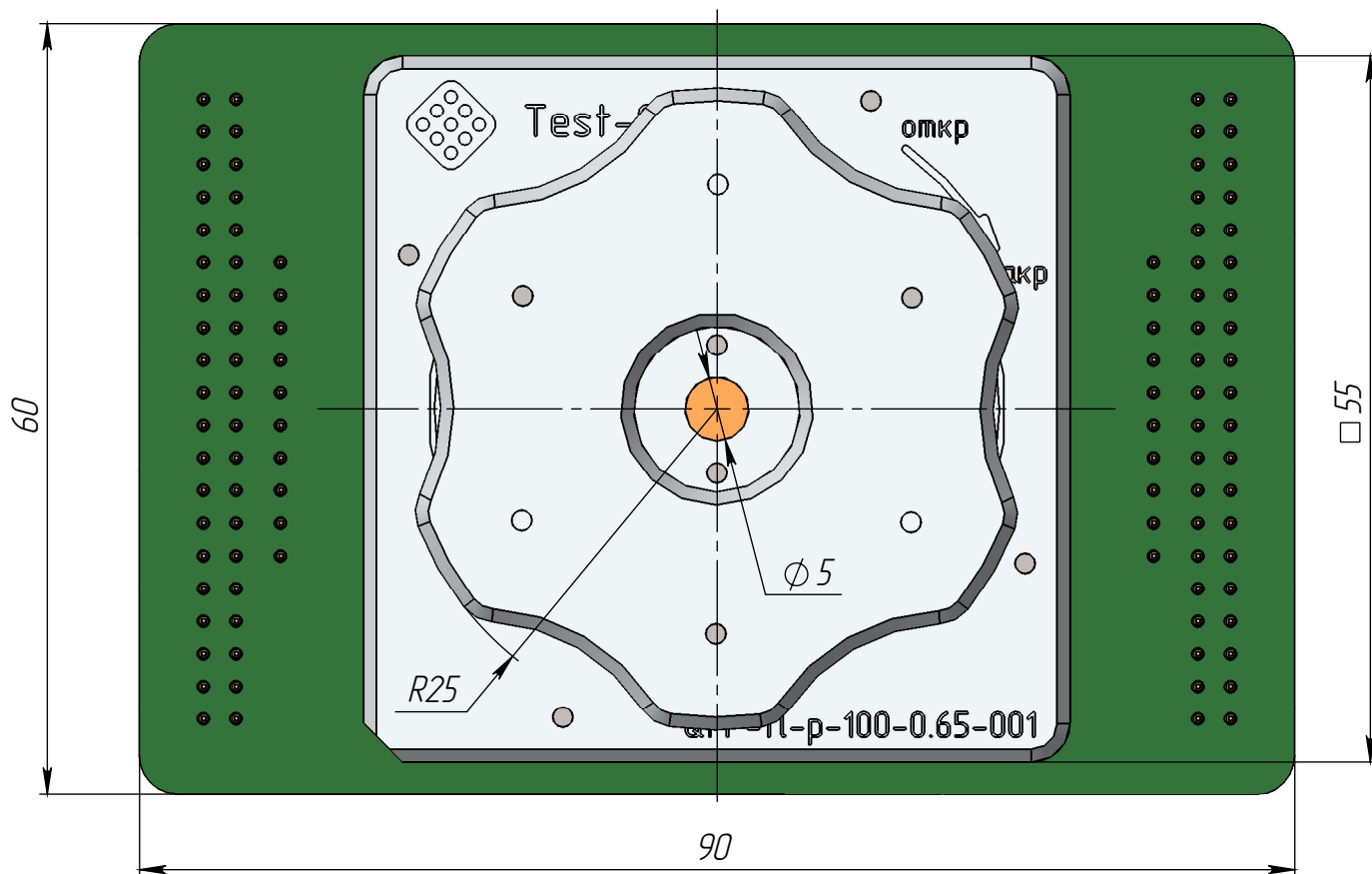
____/____2018г.

*Паспорт контактирующего устройства
QFP-tl-p-100-0.65-001*

Внешний вид и габаритные размеры КУ

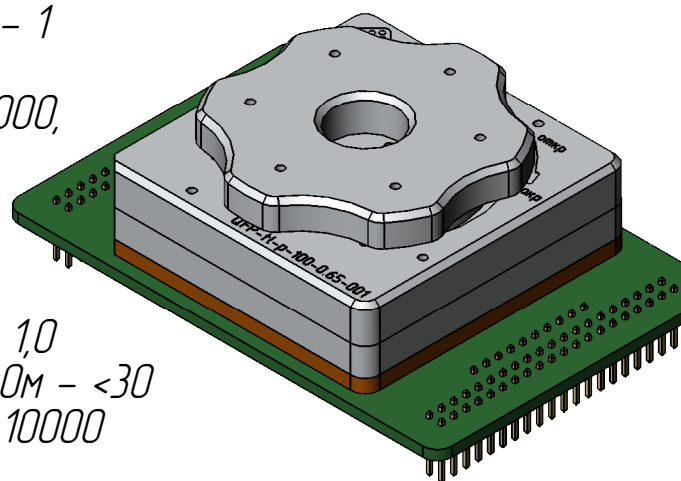


- × Фиксация КУ на посадочном месте печатной платы осуществляется болтами М2 (без пайки). Число мест крепления – 4.
- × Базирование КУ относительно платы осуществляется штифтами $\phi 1$ мм. Количество штифтов – 2 шт.



- × Количество ЭРИ, устанавливаемых в КУ, шт. – 1
- × Количество выводов КУ, шт. – 100
- × Материал КУ (торговая марка) – PEI UL TEM 1000, алюминий

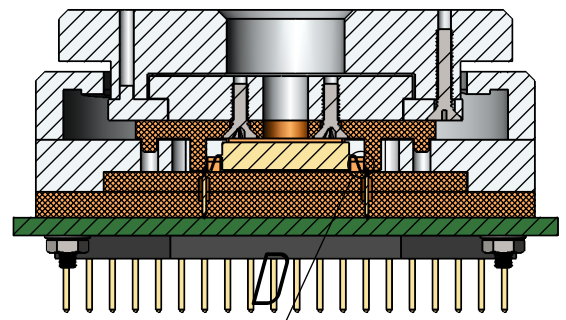
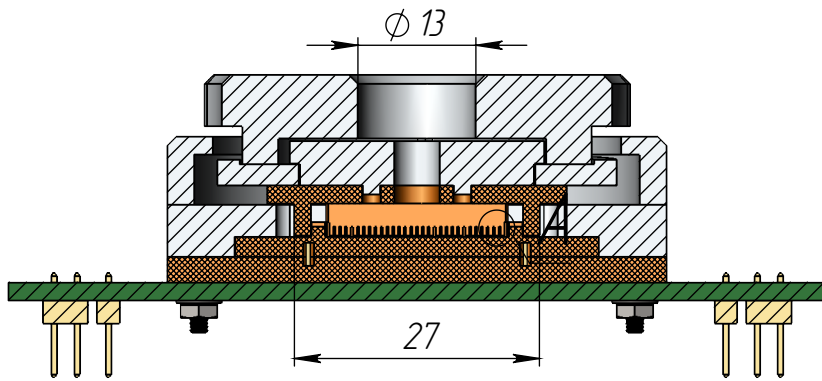
- × Материал коннекторов – ВеСи
- × Покрытие коннекторов – Au
- × Диапазон рабочих температур, °C –55...+150
- × Максимальный ток на один контакт (НУ), А – 1,0
- × Электрическое сопротивление коннектора, мОм – <30
- × Гарантированное кол-во контактирований – 10000
- × Ширина полосы, ГГц@ – 3 дБ – >1



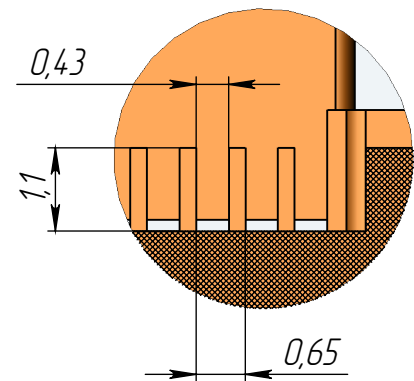
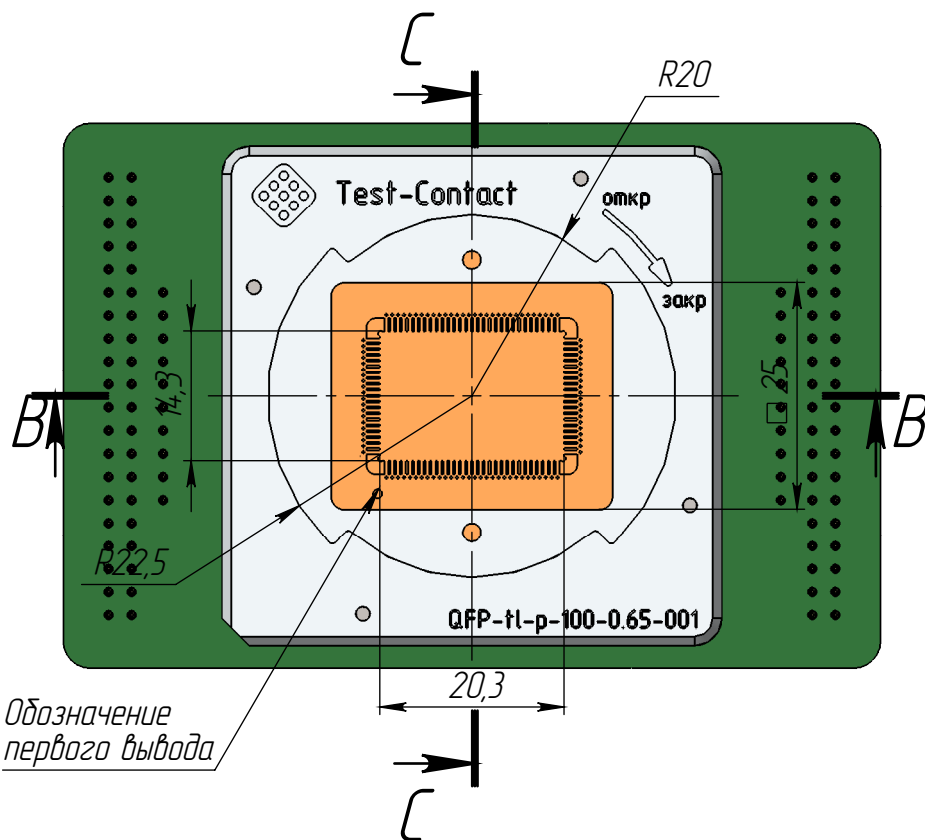
Место установки ЭРИ

B-B

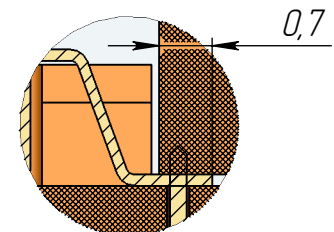
C-C



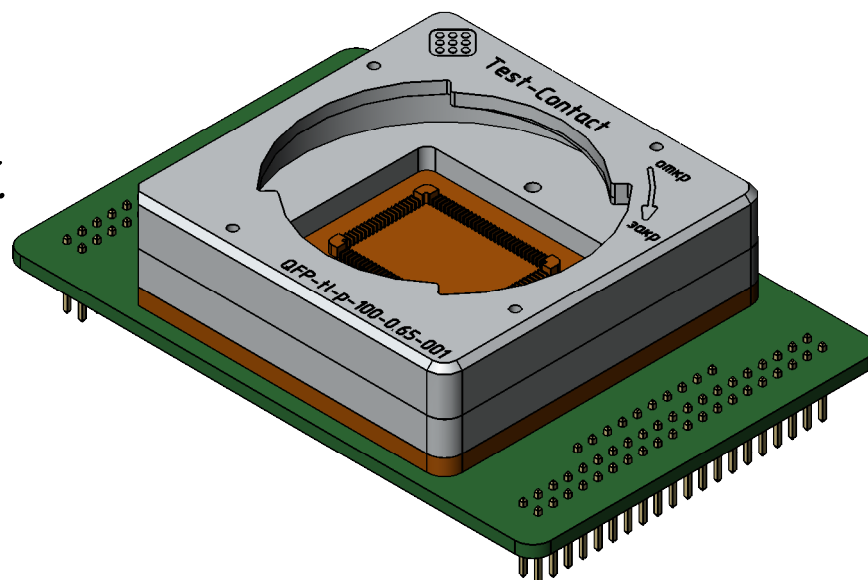
A (10 : 1)



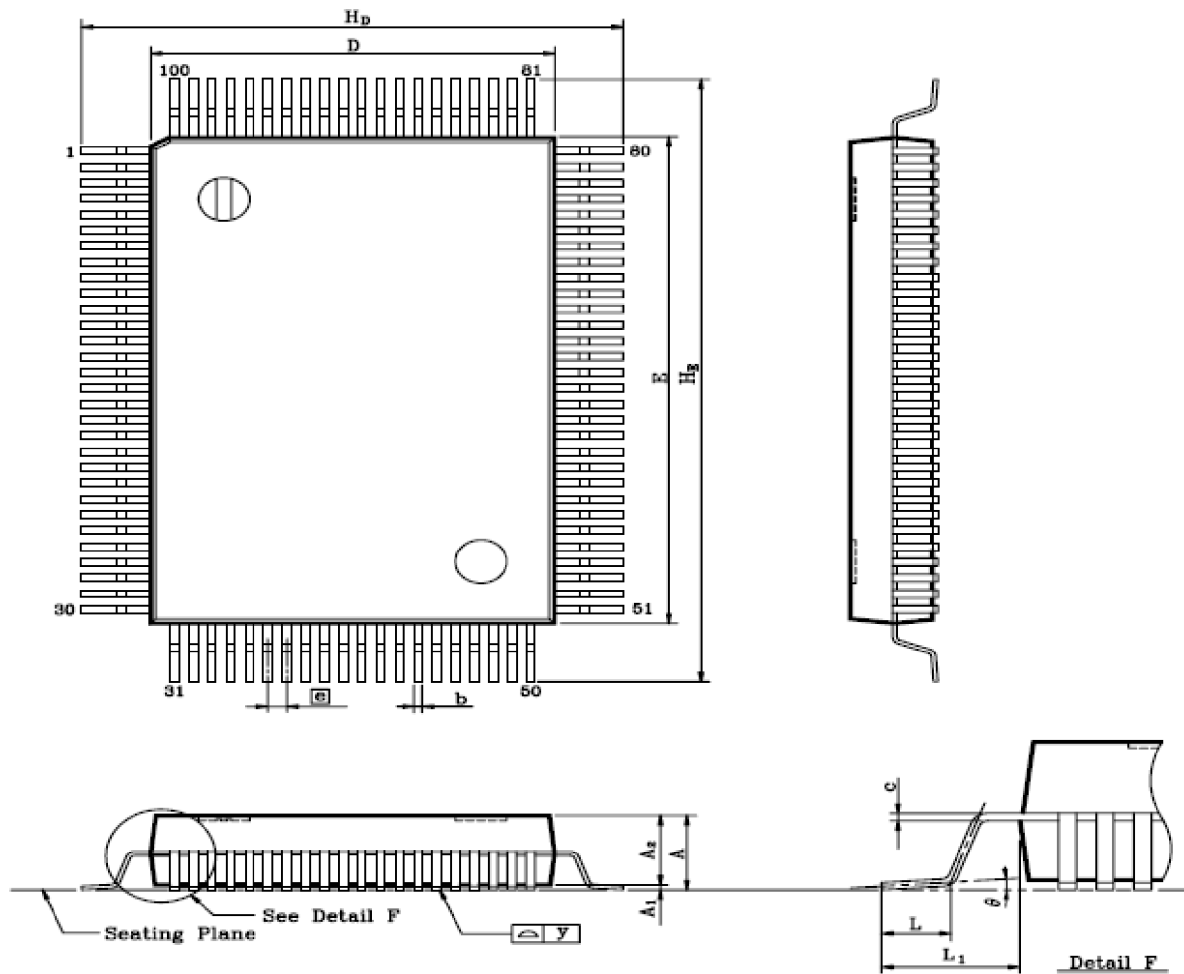
D (10 : 1)



1. *-Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-МК.



*Внешний вид и габариты ЭРИ
(предоставляется заказчиком)*



Notes:

- 1.Dimension D & E do not include interlead flash.
- 2.Dimension b does not include dambar protrusion/intrusion.
- 3.Controlling dimension: Millimeter
- 4.General appearance spec. should be based on final visual inspection spec.

Symbol	Dimension in mil			Dimension in mm		
	Min	Typical	Max	Min	Typical	Max
A	106.3	118.1	129.9	2.70	3.00	3.30
A ₁	4.3	20.1	35.8	0.11	0.51	0.91
A ₂	102.4	112.2	122.0	2.60	2.85	3.10
b	7.1	11.8	16.5	0.18	0.30	0.42
c	1.6	5.9	10.2	0.04	0.15	0.26
D	541.3	551.2	561.0	13.75	14.00	14.25
E	777.6	787.4	797.2	19.75	20.00	20.25
e	19.7	25.6	31.5	0.50	0.65	0.80
H _D	726.4	740.2	753.9	18.45	18.80	19.15
H _E	962.6	976.4	990.2	24.45	24.80	25.15
L	39.4	47.2	55.1	1.00	1.20	1.40
L ₁	88.6	94.5	104.3	2.25	2.40	2.65
Y	-	-	3.9	-	-	0.10
θ	0°	-	12°	0°	-	12°

TITLE : 100L QFP (14x20 mm**2) FOOTPRINT 4.8 mm			
PACKAGE OUTLINE DRAWING			
LEADFRAME MATERIAL:			
APPROVE		DWG NO.	
		REV NO.	
		SCALE	
CHECK	Ricardo Chen	DATE	
		SHT NO.	1 OF
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP.			

Правила эксплуатации КУ

1. Перед началом эксплуатации:

- обработать контакты КУ и площадки ПП специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом;*
- производить установку КУ после просушки ПП.*

2. В процессе эксплуатации:

Через каждый цикл ЭТТ:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом*
- промывать КУ в ультразвуковой ванне*

Через каждые 1000 циклов ВК:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом*
- промывать КУ в ультразвуковой ванне.*

3. Внимание! Предохранять контакты и рабочие поверхности КУ от соприкосновения с посторонними предметами и телами вне процесса эксплуатации изделия.